

■封面故事

- 高能效運算當道 低功耗設計為虎添翼
- 掃除導熱陰霾 拉近IC與AI的距離
- 正本清源 PCB散熱要從設計端做起

■編者的話

- 從手中有劍 到心中無劍

■新聞分析

- 為什麼台積的4奈米和3DIC整合服務是亮點？
- 打造5G開放網路驗測平台可望帶動市場新商機
- 跨域整合成效為智慧長照服務另闢良田

■產業觀察

- 鑑往知來 洞察不同應用領域的DRAM架構（下）

■產業視窗

- NEC台灣卓越中心開幕體感未來世界新樣貌
- R&S全新5G測試方案CMPQ 加速5G裝置驗證與量產

■焦點議題

- 5G時代正式啟動 高速傳輸市場熱潮再起

■CTIMES People

- 以人為本的智慧空間開發

■獨賣價值

- 新創自研AR/VR開發平台有成 推動產業共創模式

■透視智慧物聯

- AIoT架構複雜 混合雲成為入手最佳解

■矽島論壇

- Apple強化產品整合服務 生態系影響持續擴大

■專題報導-毫米波雷達

- 5G NR開啟毫米波應用新契機
- 手機晶片大廠毫米波技術專利分析

■量測進化論 - 半導體測試

- 半導體測試邁向智慧化解決方案新時代

■關鍵技術報告 - LED模組

- 智慧型後車燈
- SiC MOSFET應用技術在雪崩條件下的魯棒性評

■亭心觀測站

- 數位科技的境界

■科技有情

- 電不夠用！